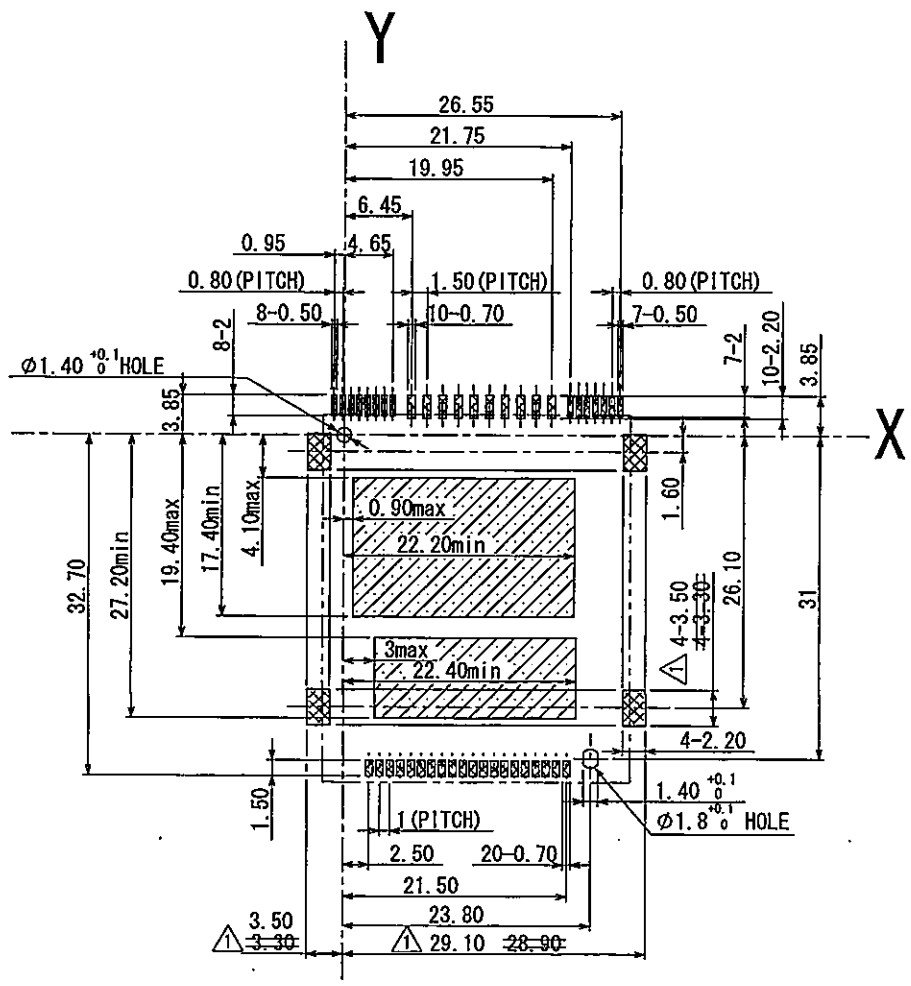





PRELIMINARY



 LAND AREA
  NO PATTERN AREA

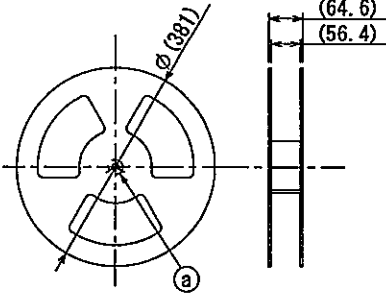
Recommended P.C. Board layout (Mounting face side)
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC. ±0.05

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.		
		DSGD. Nov. 26. 2007 H. Nakamura	SCALE 2:1			NO. SCDG1A0100	
		CHKD. Nov. 26. 2007 Y. Okabe				TITLE PRODUCT DRAWING (製品図) (2/5)	
		APFD. Nov. 26. 2007 T. Wagatsuma		UNIT mm			DOCUMENT NO. SCDG1A0100, AE25, 033
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD			

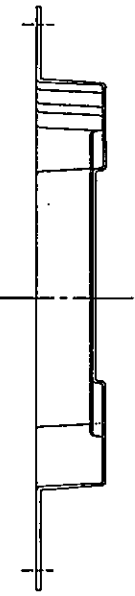
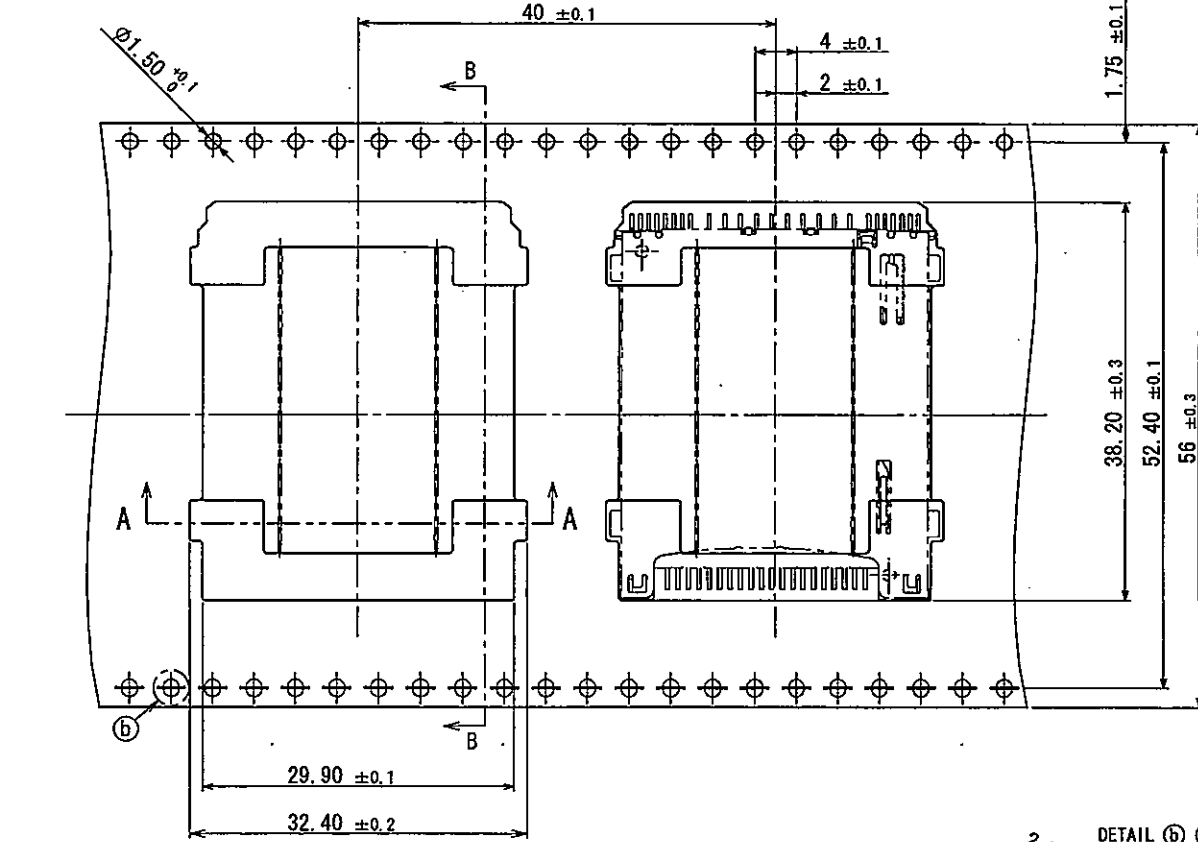
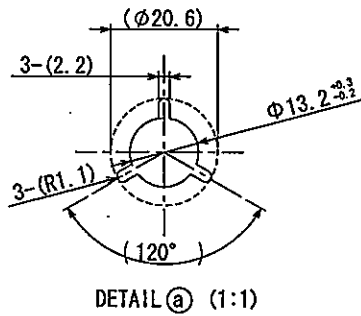
CARRIER TAPE (2:1)

PRELIMINARY

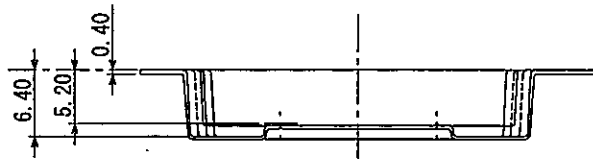
△ DESIGN CHANGE
REEL CORE (1:10)



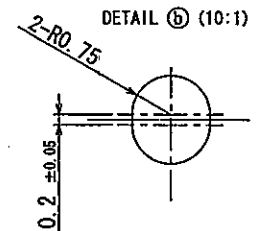
△ DESIGN CHANGE



SECTION B-B



SECTION A-A



△ 2. 300 200PIECES / REEL
NOTE 1. SPECIFICATION OF TAPING : TAPE-S-039

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.		
					DSGD. Nov. 26, 2007 H. Nakamura	SCALE 2:1	NO. SCDG1A0100
					CHKD. Nov. 26, 2007 Y. Okabe		TITLE PRODUCT DRAWING (製品図) (3/5)
					APPD. Nov. 26, 2007 T. Wagatsuma		UNIT mm
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD			

PRELIMINARY

★ ご使用上の注意 CAUTION IN USE

1. コネクタの取り扱い上の注意 CONNECTOR HANDLING PRECAUTIONS

- (1) コネクタ上面からフラックスが侵入しないようにして下さい。
SAFEGUARD THE CONNECTOR ASSEMBLY AGAINST FLUX PENETRATION FROM ITS TOP SIDE.
 - (2) 本製品は無洗浄を前提として設計しており、洗浄された場合、電気的・機械的特性が劣化することがあります。
洗浄される場合は事前に連絡をお願いします。
THIS PRODUCT IS DESIGNED ON THE ASSUMPTION THAT THEY WILL NOT BE WASHED AFTER SOLDERING.
IF YOU WASH IT, IT MAY BE CAUSE DETERIORATION OF MECHANICALLY AND ELECTRICALLY.
IF WASHING IS NECESSARY, PLEASE MAKE CONTACT WITH US BEFOREHAND.
2. タンシを半田付けされる場合、タンシに荷重がかかりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意ください。
WHEN SOLDERING TERMINALS, THERE IS A DANGER THAT LOAD PLACED ON THE TERMINALS MAY CAUSE RATTLE, DEFORMATION OR ELECTRICAL DEGRADATION TO OCCUR DEPENDING ON THE CONDITIONS. CAUTION IS THEREFORE REQUIRED.
 3. 半田付けの際、水溶性フラックスは製品を腐食させるおそれがありますので、ご使用はお避け下さい。
WHEN SOLDERING, DO NOT USE WATER SOLUBLE FLUX BECAUSE THIS MAY CORRODE THE PRODUCT.
 4. リフロー条件の設定については実際の量産条件で確認されるようお願いいたします。
REGARDING THE SETTING OF REFLOW CONDITIONS, PLEASE CONFIRM THEM WITH THE ACTUAL MASS PRODUCTION CONDITIONS.
 5. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計、レイアウトについては十分考慮願います。
AS P.W.B. WARPING MAY ALTER CHARACTERISTICS, PLEASE TAKE THIS INTO CONSIDERATION WHEN DESIGNING PATTERN AND LAYOUT.
 6. プリント基板の取付け穴は、製品図に記載の指定寸法をご使用下さい。
THE DIMENSIONS OF HOLES FOR MOUNTING A P.C.B. SHALL CONFORM TO THE DIMENSIONS IN THE PRODUCT DRAWING.
 7. イジェクタ押し込み位置で半田付けを行わないでください。
PLEASE DO NOT SOLDER AT THE EJECTOR PUSHING POSITION.
 8. 当製品は、本来AV、家電、事務機、通信機などの一般電子機器用に設計、製造したものです。したがって、高度の安全性および信頼性を必要とする医療・航空・宇宙機器、防犯機器などにご使用の際は、セットメーカー様において当該製品の適合性について十分なご確認をお願いします。
THIS PRODUCT HAVE BEEN DESIGNED AND MANUFACTURED FOR APPLICATIONS TO ORDINARY ELECTRONIC EQUIPMENT AND DEVICES SUCH AS THE AV EQUIPMENT ELECTRIC HOME APPLIANCES, OFFICE MACHINES AND COMMUNICATIONS EQUIPMENT. CONSEQUENTLY, WHEN EMPLOYING THESE PRODUCTS FOR APPLICATIONS REQUIRING A HIGH DEGREE OF SAFETY AND RELIABILITY SUCH AS THE MEDICAL EQUIPMENT, AVIATION AND AIRCRAFT EQUIPMENT, SPACE EQUIPMENT AND BURGLAR ALARM EQUIPMENT, THE USING MANUFACTURERS WILL PLEASE THOROUGHLY STUDY THE PROPRIETIES OF THESE PRODUCTS FOR THE PLANNED APPLICATIONS.
 9. 接点部、端子部の硫化及び酸化等による接触障害や、皮膜形成によるはんだ付け性の劣化等を防ぐ為に以下の点にご配慮下さい。
TO PREVENT CONTACT DISTURBANCE BY THE SULFURATION OR OXIDATION OF THE CONTACT AND TERMINAL, AND DETERIORATION OF SOLDER ABILITY BY THIN FILM ON THE TERMINAL, PLEASE NOTE FOLLOWING.
 - ・ 高温高湿及び硫黄、塩素等の腐食性ガスの発生する恐れのある場所での保管、ならびに過剰な積み重ねはお避け下さい。
STORAGE IN THE ATMOSPHERE OF HIGH TEMPERATURE, HIGH HUMIDITY, CORROSIVE GASES SUCH AS SULFUR OR CHLORINATE GAS, AND EXCESSIVE PILING UP OF THE CARTON BOXES SHALL BE AVOIDED.
 - ・ コネクタは開梱せずに常温常湿で保管し、納入後3ヶ月以内を目安として、遅くとも6ヶ月以内でのご使用下さい。
CONNECTORS SHALL BE STORED AS THE PACKAGE NOT OPENED AND IN THE NORMAL TEMPERATURE AND NORMAL HUMIDITY, AND THE CONNECTORS SHALL BE USED PREFERABLY WITHIN 3 MONTHS, AT LEAST WITHIN 6 MONTHS.
 - ・ 開梱後保管する際は、ポリ袋等で密封し直射日光の当たらない冷暗所に保管し、速やかにご使用下さい。
WHEN THE CONNECTORS ARE STORED AFTER OPENING THE PACKAGE, THE CONNECTORS SHALL BE SEALED WITH A POLYETHYLENE BAG ETC. AND STORED IN DARK AND COOL PLACE, AVOIDING DIRECT SUNLIGHT. THE CONNECTORS SHALL BE USED AS SOON AS POSSIBLE.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.		
					DSGD. Feb. 25. 2008	SCALE	NO.
					H. Nakamura		SCDG1A0100
					CHKD. Feb. 25. 2008		TITLE
					Y. Okabe		PRODUCT DRAWING (製品図) (4/5)
					APPD. Feb. 25. 2008	UNT	DOCUMENT NO.
					T. Wagatsuma		SCDG1A0100, AE45, 033
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD			

★ ご使用上の注意 CAUTION IN USE

PRELIMINARY

10. コネクタ上面の金属カバーに力を加えたり、押えつけない様にして下さい。
カードがイジェクトされない場合や、その他機能に影響を与える可能性があります。
DON'T PUSH OR HOLD DOWN THE METAL COVER OF THE CONNECTOR, OTHERWISE THERE IS A POSSIBILITY THAT THE CARD WOULD NOT BE EJECTED OR INFLUENCES TO OTHER FUNCTION.
11. スイッチのON, OFF切り替え動作時のバウンス及び、外部振動などのチャタリングによる誤動作防止の為下記のような配慮をお願いします。
PLEASE ATTENTION FOLLOWING ITEMS TO PREVENT CONNECTOR FROM MISS OPERATION, SUCH AS BOUNDING CAUSED BY ON/OFF SWITCHING AND CHATTERING BY VIBRATION
- ・ 複数回の読みこみを行なう。
REPEATED READING/WRTING.
 - ・ ディレイタイムを設定する。400msec以上を推奨します。
ESTABLISH DELAY TIME-RECOMMENDED 400msec MIN.
 - ・ OR積分回路を設定する。
ESTABLISH OR ACCUMULATION CIRCUIT.
12. 本製品は規格に準拠していないカードを使用した場合、正常に動作しない可能性があります。
THIS PRODUCT DOES NOT OPERATE NORMALLY WHEN THE CARD WHICH DOES NOT CONFORM TO THE SPECIFICATION IS USED OCCASIONALLY.
13. 本コネクタにはxDとSDカード(MMC HSMHC含む) それぞれにカード検出スイッチを設けています。
各カード検出がONしてから端子信号の読み取りを行うよう、ご配慮願います。
THIS CONNECTOR HAS THE CARD DETECTION SWITCH OF XD AND SD MEMORY CARD (INCLUDING MMC HSMHC).
PLEASE READ TERMINALS SIGNAL, AFTER EACH CARD DETECTION SWITCH TURNS ON.
14. 十分な静電対策が必要な場合には、別途筐体にて対策を行ってください。
WHEN AN ELECTROSTATIC COUNTERMEASURE IS NECESSARY, PLEASE ADOPT SUCH COUNTERMEASURES IN THE APPLICATION SET.
15. 背面リフローを行う際には製品が落下する恐れがありますので、熱硬化性接着剤等にて固定することを推奨致します。
接着剤塗布範囲については別途ご相談下さい。
THERE IS A POSSIBILITY THAT THE PRODUCT WOULD FALL WHEN THE REVERSE SIDE REFLOW IS DONE.
WE WILL RECOMMEND TO FIX THIS PRODUCT WITH A THERMOSETTING ADHESIVE ETC.
PLEASE CONTACT TO US ABOUT THE RANGE OF THE ADHESIVE SPREADING SEPARATEL
16. 生産地：日本、中国
COUNTRY OF ORIGIN : JAPAN / CHINA.
17. t=0.15以上のメタルマスクを推奨します。t=0.15以下でご使用の際は十分に半田付け性を確認くださるようお願いいたします。
Recommending a metalmask more than 0.15mm thick. Please confirm solderability, if use a metalmask less than 0.15mm thick.
18. マウンターでの吸着時に、5N以上の荷重を加えないでください。
PLEASE DO NOT ADD THE FORCE OF 5N OR MORE WHEN YOU ADSORB IT IN THE MOUNTER.
19. カード 抜け防止 CARD OMISSION PREVENTION
本品にはカード 抜け防止用の蓋が設けられていないため、カードを嵌合した状態で落下させたり熱衝撃試験を行ったりするとカードが抜けてきます。
したがって、筐体にカード 抜け防止用の蓋を設置してください。その際、カードロック状態でのカードと蓋の隙間は0.3mm以下にしてください。
0.3mm以上の隙間があると、カード認識スイッチの接触が切れる場合があります。
THE LID, FUNCTIONALLY PREVENTING THE CARD FROM COMING OFF, IS NOT DESIGNED ON THE CONNECTOR.
SO THAT, THERE IS A POSSIBILITY THAT THE CARD COMES OFF WHEN DROPPED OR DONE THE THERMAL-SHOCK TEST.
THEREFORE, THE LID IS RECOMMENDED TO BE DESIGNED PREVENT THE CARD FROM COMING OFF FROM THE BODY.
IN THAT CASE, PLEASE DESIGN THE 0.3mm OR LESS SPACE BETWEEN THE CARD AND THE LID WHEN THE CARD IS LOCKED INTO THE CONNECTOR.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.		
					DSGD. Feb. 25. 2008	SCALE	NO.
					H. Nakamura		SCDG1A0100
					CHKD. Feb. 25. 2008		TITLE
					Y. Okabe		PRODUCT DRAWING (製品図) (5/5)
					APPD. Feb. 25. 2008	UNT	DOCUMENT NO.
					T. Wagatsuma	UNIT	SCDG1A0100, AE55, 033
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD			